



# 第27期 中間(第2四半期)報告書

平成23年4月1日から平成23年9月30日まで

東京エレクトロン デバイス株式会社

証券コード 2760

## 株主の皆様へ

株主の皆様には、平素から格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。  
 当社第27期中間報告書（平成23年4月1日から平成23年9月30日まで）  
 として事業の概況等をご報告いたします。



代表取締役副社長 久我 宣之  
 代表取締役社長 栗木 康幸

## 当中間期(第2四半期)の経営成績

当中間期におけるわが国経済は、東日本大震災によるサプライチェーンの一時的な寸断や夏場の節電による生産活動への影響を受ける中、景気回復に向けた持ち直しの動きが出てまいりましたが、欧州を中心とした金融資本市場の混乱や北米経済の低迷、夏場以降の円高進行等、先行きには不透明感が残る状況となっております。

当社グループが参画しているエレクトロニクス業界では、PCやテレビをはじめとしたデジタル家電関連の需要が総じて減退しており、これに伴い半導体や電子部品は在庫調整の局面となっております。IT投資に関しては、震災や電力消費制限の影響があるもの

の、クラウドコンピューティングやデータセンターの利用に対して関心が高まりつつある状況となっております。

当社グループにおける当中間期の業績については、売上高417億8千7百万円（前年同期比8.2%減）、営業利益8億2千2百万円（前年同期比28.5%減）、償却債権取立益及び為替差益の計上等により、経常利益12億6千3百万円（前年同期比1.4%増）、前年同期において計上した特別利益が当期は発生していないことから、四半期純利益6億9千9百万円（前年同期比18.9%減）となりました。

## 連結業績ハイライト

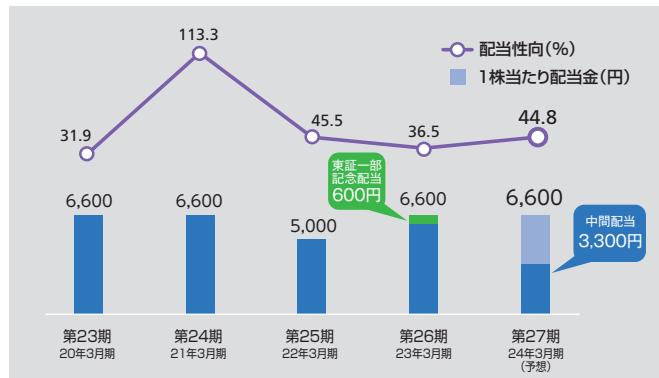


## 株主還元について

当社は、株主重視を経営の最重要事項の一つと位置付けており、継続的かつ安定的な配当実施を基本として、業績を反映した適正な利益還元を原則としております。

当面の配当性向の水準については連結当期純利益の35%程度を目安といたします。

当中間配当につきましては、3,300円とさせていただきます。期末配当につきましても3,300円を予定しております。



	平成23年3月期		平成24年3月期	
	中間	期末	中間	期末(予想)
1株当たり配当金(円)	3,000	3,600*	3,300	3,300
配当性向	36.5%		44.8% (予想)	

(※) 平成23年3月期期末配当…普通配当3,000円、上場記念配当600円

## 平成24年3月期 連結業績予想

昨年後半から低調であったデジタル家電に係る需要が、東日本大震災の影響や世界経済の先行き不透明感により一層低迷している中、現時点における半導体関連の市場予測からも、急速な需要回復には至らない見通しであることなどを踏まえ、通期連結業績予想を修正いたします。

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想(A) 4月27日	95,000	3,370	3,250	1,950	18,396.23
今回発表予想(B) 9月24日	88,000	2,375	2,750	1,560	14,716.98
増減額 (B-A)	△ 7,000	△ 995	△ 500	△ 390	-
増減率 (%)	△ 7.4	△ 29.5	△ 15.4	△ 20.0	-

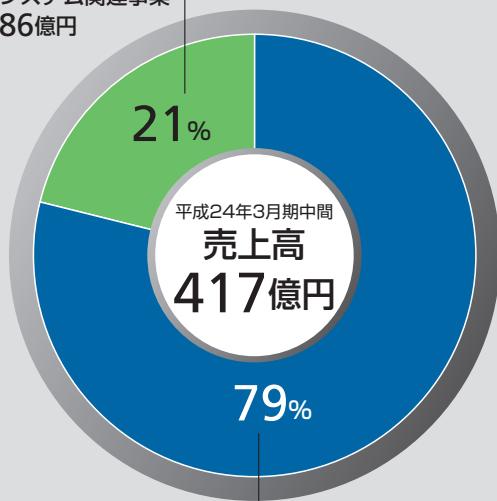
## 当社子会社による事業譲受けについて

当社は、平成23年11月7日の取締役会において、当社連結子会社であるパネトロン株式会社が株式会社アムスクより、テキサス・インスツルメンツ社製品の販売代理店事業を譲受けることを決議し、同日に公表いたしました。公表資料は当社ホームページなどからご覧いただけます。なお、事業譲受け期日が平成24年4月1日(予定)のため、平成24年3月期 連結業績への影響はありません。

## 事業紹介

当社グループは、半導体製品、電子部品他の仕入・販売および設計・開発を展開する「半導体及び電子デバイス事業」と、コンピュータ・ネットワーク機器、ソフトウェアをソリューションで提供する「コンピュータシステム関連事業」を展開しております。

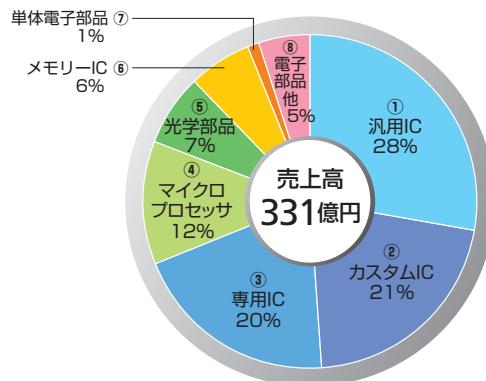
コンピュータ  
システム関連事業  
86億円



半導体及び  
電子デバイス事業  
331億円

## 半導体及び電子デバイス事業

## 品目別売上構成



## ① 汎用 IC

色々な用途に  
使用されるIC



## 主な商品と仕入先

アナログIC (リニアテクノロジー社)  
ロジックIC (テキサス・インスツルメンツ社)

## 主な最終製品

カーナビゲーション、FA機器、OA機器、  
デジタル家電、携帯電話基地局

## ⑤ 光学部品

電気を光に変換して  
使用する電子部品



## 主な商品と仕入先

LED<sup>\*3</sup>、フォトカプラ<sup>\*4</sup>(アバゴ・テクノロジー社)

## 主な最終製品

携帯電話、車載機器、FA機器

## 当中間期(第2四半期)の業績

デジタル家電関連の需要回復には時間を要するものと予測されることに加え、これまで回復基調が続いていた産業機器関連にも減速感が生じるなど、様々な分野で需要が低調に推移する中、当中間期における売上高は331億7千万円(前年同期比11.5%減)、セグメント利益(経常利益)は6億7千5百万円(前年同期比39.9%減)となりました。

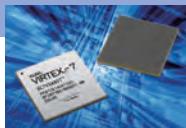
## 技術サポート

仕入先ごとに専属のエンジニア(FAE)を配置し、お客様への新製品の技術説明や技術的な問い合わせ対応などきめ細かい技術サポートを行っております。



### ② カスタム IC

お客様の仕様に  
応じて作られるIC



#### 主な商品と仕入先

PLD<sup>\*1</sup>(ザイリンクス社)  
ASIC<sup>\*2</sup>(富士通セミコンダクター株)

#### 主な最終製品

医療機器、FA機器、デジタル家電、プリンター

### ③ 専用 IC

特定用途向けに  
作られるIC



#### 主な商品と仕入先

画像補正用(ピクセルワークス社)  
画像圧縮用(ピクシシステムズ社)  
通信用(ザーリンク・セミコンダクター社)  
セキュリティ用(インレビウム) **inrevium**

#### 主な最終製品

液晶プロジェクタ、デジタルTV、DVD、  
携帯電話基地局、監視カメラ

### ④ マイクロプロセッサ

コンピュータの  
頭脳として演算・制御  
機能を持つIC



#### 主な商品と仕入先

マイクロプロセッサ(フリースケール・セミコンダクタ社)  
DSP(テキサス・インスツルメンツ社)

#### 主な最終製品

携帯電話基地局、プリンター、  
医療機器、カーナビゲーション

### ⑥ メモリー IC

記憶専用のIC



#### 主な商品と仕入先

フラッシュメモリ<sup>\*5</sup>(富士通エレクトロニクス株)  
SRAM(IDT社)

#### 主な最終製品

デジタル家電、携帯電話、  
通信機器、FA機器

### ⑦ 単体電子部品

増幅や整流など  
単機能部品



#### 主な商品と仕入先

ディスクリート(オン・セミコンダクター株)

#### 主な最終製品

PC、FA機器

### ⑧ 電子部品他

ボード、電源など



#### 主な商品と仕入先

評価ボード(インレビウム) **inrevium**  
電源(コーセル株)

#### 主な最終製品

デジタル家電、医療機器、FA機器、通信機器

※1【PLD】プログラム可能な論理素子のカスタムIC。ASICより短期開発が可能。

※2【ASIC】高性能が望めるが、開発期間が長くかかるカスタムIC。

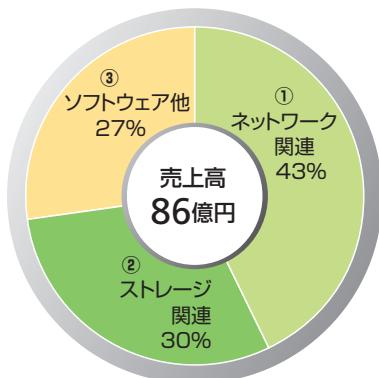
※3【LED】電流を流すと発光するダイオード。ランプや表示器に使用。

※4【フォトカプラ】電気信号を光に変換して伝達する素子。電気的な絶縁が利点。

※5【フラッシュメモリ】データを電氣的に保存するメディア。電源が切れても保持が可能。

## コンピュータシステム関連事業

### 品目別売上構成



### 当中間期(第2四半期)の業績

クラウド化によるコスト削減メリットや、災害対策の観点に基づくデータセンターの利用が拡大する傾向にある中、製品販売が堅調に推移し、当中間期における売上高は86億1千7百万円（前年同期比6.9%増）、償却債権取立益の計上等によりセグメント利益（経常利益）は5億8千7百万円（前年同期比377.6%増）となりました。

#### ① ネットワーク関連

インターネットの接続負荷の分散、セキュリティ強化



##### 主な仕入先

F5ネットワークス社  
エクストリーム社  
タレス社 他

#### ② ストレージ関連

大容量データの記憶、統合技術によるコスト削減



##### 主な仕入先

プロケード・コミュニケーションズ・システムズ社  
イーエムシー社  
エミュレックス社 他

#### ③ ソフトウェア他

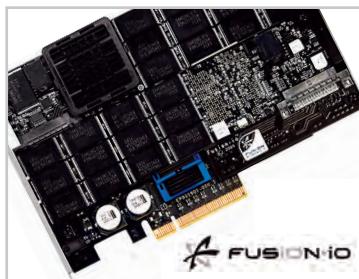
組み込み機器向けのOSやデータ管理を行うデータベース



##### 主な仕入先

日本マイクロソフト社  
オラクル社 他

### 注力製品 超高速半導体ストレージ製品「Fusion-io社製 ioDrive」

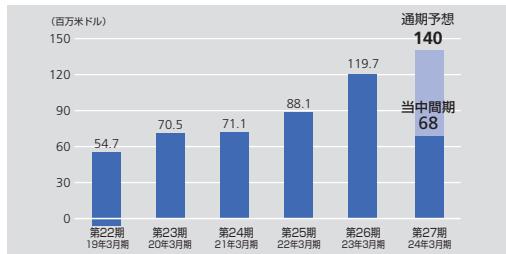


米国Fusion-io社の主力商品「ioDrive」は、NANDフラッシュメモリをPCIeカード型に実装したストレージ製品です。大規模SANストレージと同等の性能があり、年間の消費電力を抑制しつつ、コスト削減を図れるほか、システムを高速化させる機能も備わっている製品です。大規模なWebサービスや大規模データベースなどに使用されるストレージシステムとして注目されています。

## 注力ビジネス

## 海外ビジネス

## ■ 海外連結子会社売上高推移



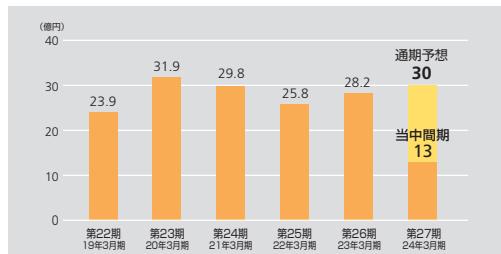
## ■ 当期活動方針

- 1 海外現地企業への販売強化
- 2 自社ブランド商品の海外顧客販売拡大

## ■ 海外営業展開

開発ビジネス *inrevium*

## ■ 開発ビジネス売上高推移



## ■ 自社ブランド商品開発事例

## 小型CPUモジュールを開発

- インテル® Atom™ プロセッサE600番台を搭載
- 小型CPUモジュール上にパソコンの基本機能を実現
- 省スペース化、低消費電力、開発期間の短縮に効果を発揮

## 〈主な応用分野〉

インターネット接続可能な組み込み機器、  
医療機器、車載機器、電子看板など

〔CoreE600 (TD-BD-C592LF)〕



## 新ビジネス

## ■ 環境・省エネルギー関連商品を拡充

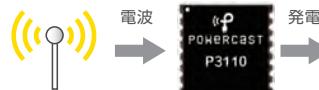
無線 RF

環境発電デバイス

高性能リチウム電池

電波からの発電が可能

発電した電力を蓄電



パワーキャスト社



インフィニット・パワー・ソリューションズ社

## 連結財務諸表

## 中間（第2四半期）連結貸借対照表

資産の部	前 期	当第2四半期
	(平成23年3月31日現在)	(平成23年9月30日現在)
	千円	千円
流動資産	45,251,175	42,444,759
現金及び預金	1,373,240	1,437,389
受取手形及び売掛金	21,025,318	18,621,470
商品及び製品	19,247,439	17,841,088
仕掛品	99,889	140,731
その他	3,656,364	4,543,793
貸倒引当金	△151,076	△139,714
固定資産	5,003,664	4,862,149
有形固定資産	1,469,616	1,391,065
無形固定資産	390,339	407,601
投資その他の資産	3,143,707	3,063,482
資産合計	50,254,839	47,306,909

## ■ 資産

総資産は473億6百万円となり、前連結会計年度末に比べ29億4千7百万円の減少となりました。これは主に、未収入金(流動資産の「その他」)が増加した一方、受取手形及び売掛金、商品及び製品が減少したことによりです。

## ■ 負債

負債総額は237億7千2百万円となり、前連結会計年度末に比べ32億6千1百万円の減少となりました。これは主に、短期借入金が減少したことによりです。

負債の部	前 期	当第2四半期
	(平成23年3月31日現在)	(平成23年9月30日現在)
	千円	千円
流動負債	21,280,981	17,817,052
買掛金	7,360,850	6,528,968
短期借入金	7,996,405	5,152,082
未払法人税等	463,167	640,959
賞与引当金	1,052,640	621,357
役員賞与引当金	42,150	18,183
その他	4,365,768	4,855,502
固定負債	5,753,127	5,955,124
退職給付引当金	5,141,885	5,331,846
役員退職慰労引当金	128,698	141,760
その他	482,543	481,518
負債合計	27,034,108	23,772,177
純資産の部		
株主資本	23,379,348	23,696,864
資本金	2,495,750	2,495,750
資本剰余金	5,645,240	5,645,240
利益剰余金	15,238,358	15,555,873
その他の包括利益累計額	△158,618	△162,132
繰延ヘッジ損益	△29,659	19,460
為替換算調整勘定	△128,959	△181,593
純資産合計	23,220,730	23,534,731
負債及び純資産合計	50,254,839	47,306,909

## ■ 純資産

純資産総額は235億3千4百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億1千4百万円の増加となりました。自己資本比率は49.7%となり前連結会計年度末に比べ3.5ポイント向上いたしました。

## 中間（第2四半期）連結損益計算書

科 目	前第2四半期累計	当第2四半期累計
	(平成22年4月1日から 平成22年9月30日まで)	(平成23年4月1日から 平成23年9月30日まで)
	千円	千円
売上高	45,535,731	41,787,355
売上原価	37,808,915	34,464,491
売上総利益	7,726,815	7,322,863
販売費及び一般管理費	6,575,936	6,500,275
営業利益	1,150,878	822,588
営業外収益	128,890	475,522
営業外費用	32,761	34,201
経常利益	1,247,007	1,263,909
特別利益	116,343	—
特別損失	52,114	14,544
税金等調整前四半期純利益	1,311,235	1,249,365
法人税等	449,541	550,250
少数株主損益調整前四半期純利益	861,694	699,115
四半期純利益	861,694	699,115

## 中間（第2四半期）連結キャッシュ・フロー計算書

科 目	前第2四半期累計	当第2四半期累計
	(平成22年4月1日から 平成22年9月30日まで)	(平成23年4月1日から 平成23年9月30日まで)
	千円	千円
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,316,124	3,408,234
投資活動によるキャッシュ・フロー	△145,755	△143,106
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,247,074	△3,193,171
現金及び現金同等物に係る換算差額	△19,682	△7,805
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△234,487	64,149
現金及び現金同等物の期首残高	1,621,262	1,373,240
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,386,775	1,437,389

(注) 連結財務諸表の記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結財政状態



## 株式情報 (平成23年9月30日現在)

### 株式の状況

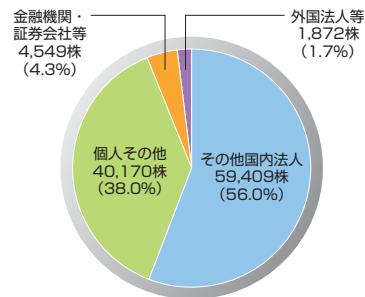
● 発行可能株式総数	256,000株
● 発行済株式の総数	106,000株
● 株主数	5,355名

### 大株主

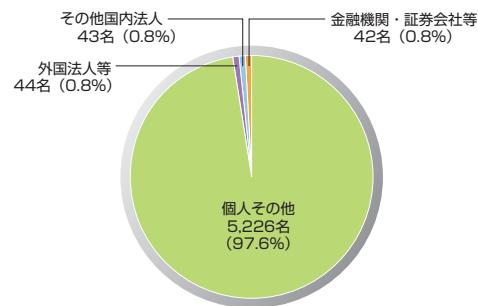
株主名	持株数	出資比率
	株	%
東京エレクトロン株式会社	58,753	55.4
東京エレクトロンデバイス社員持株会	4,534	4.3
日本マスタートラスト信託銀行(信託口)	737	0.7
日本トラスティ・サービス信託銀行(信託口)	722	0.7
ノーザン トラスト カンパニー エイビー エフシー リ ノーザン トラスト ガン ジー ノン トリーティー クライアantz	549	0.5

### 株式分布状況

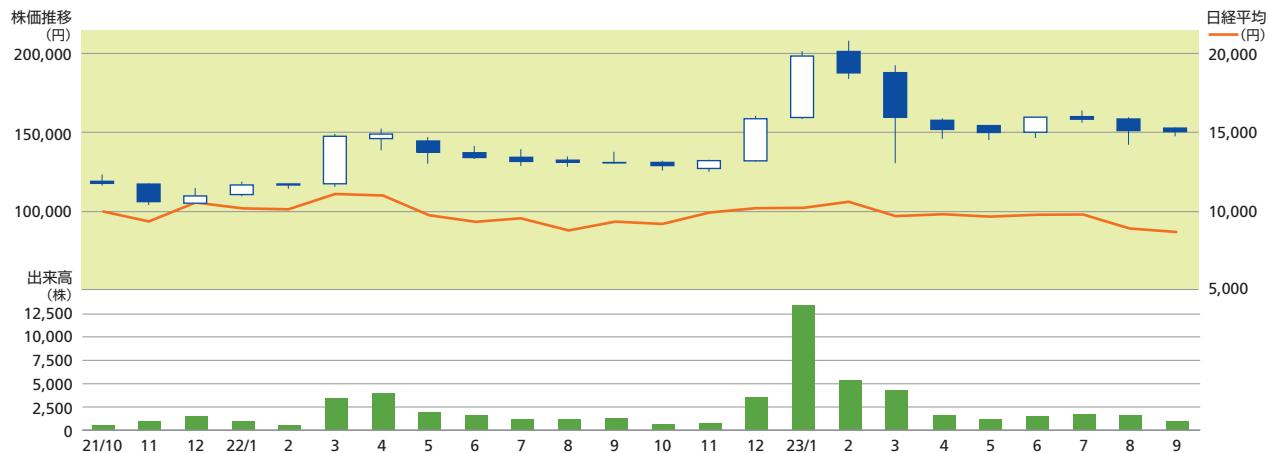
#### 所有者別株式数



#### 所有者別株主数



### 株価と出来高



## 会社の概要 (平成23年9月30日現在)

### 会社概要

商号	東京エレクトロン デバイス株式会社 TOKYO ELECTRON DEVICE LIMITED
設立	昭和61年3月3日
資本金	2,495,750,000円
従業員数	906名(連結)
本社	神奈川県横浜市神奈川区金港町1番地4 横浜イーストスクエア

### 主な拠点

#### 半導体及び電子デバイス事業

横浜営業部(第一・第二・第三・第四・第五)

大宮支社

名古屋支社

大阪支社

仙台営業所 水戸営業所

厚木営業所 立川営業所

長岡営業所 松本営業所

三島営業所 浜松営業所

京都営業所 姫路営業所

広島営業所 福岡営業所

大宮支社郡山サテライト(福島県郡山市)

大宮支社営業第4グループ(栃木県宇都宮市)

#### 設計開発拠点

仙台設計開発センター

エンジニアリングセンター(横浜市)

#### グループ会社

上海華燊電子有限公司(通称:TED上海)

香港華燊電子有限公司(通称:TED香港)

無錫華燊電子科技有限公司(通称:TED無錫)

Tokyo Electron Device Singapore Pte. Ltd.(通称:TEDシンガポール)

パネトロン株式会社

#### コンピュータシステム関連事業

新宿オフィス

名古屋オフィス

大阪オフィス

つくば営業所

### 役員等

#### 取締役

取締役会長	砂川俊昭
代表取締役社長	栗木康幸
代表取締役副社長	久我宣之
取締役	木村勉
取締役	天野勝之
取締役	徳重敦之
取締役	東哲郎
取締役	中村隆
取締役	岩田義文(注)

#### 監査役

常勤監査役	浅野升徳
常勤監査役	武井弘
監査役	林田謙一郎(注)
監査役	川勝正昭(注)

- (注) 1. 岩田義文氏は、社外取締役であります。  
2. 林田謙一郎氏および川勝正昭氏は社外監査役であります。

#### 執行役員

栗木康幸
久我宣之
木村勉
天野勝之
徳重敦之
穴倉弘明
大崎正之
八幡浩司
黒田修治
林英樹
石崎敏之
初見泰男
上小川昭浩

## 個人投資家様向けIR活動

当社は、新聞社や証券会社などが主催するIRフェアや個人投資家説明会に参加しております。  
また、当社ホームページ内に個人投資家様向け専用サイトをご用意し、事業内容、業績情報などの配信に努めております。



- 日経IRフェア2011  
(平成23年8月26日～27日 東京ビッグサイト)



- 当社IRサイト:  
<http://www.teldevice.co.jp/ir/>

### 主なコンテンツ

トップメッセージ  
IR最新情報  
経営戦略  
決算・財務情報  
会社情報  
株式情報  
IR資料室  
IRスケジュール  
個人投資家の皆様へ など

## 株主メモ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月
基準日	定時株主総会については、毎年3月31日 その他必要があるときは、あらかじめ公告する一定の日
配当支払株主確定日	期末配当 毎年3月31日 中間配当 毎年9月30日
株主名簿管理人	東京都港区芝三丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社
(郵便物送付先) 電話照会先)	〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 中央三井信託銀行株式会社証券代行部 証券代行事務センター 0120-78-2031 (フリーダイヤル)
同取次所	中央三井信託銀行株式会社 全国各支店 日本証券代行株式会社 本店および全国各支店
公告の方法	電子公告
上場金融商品取引所	東京証券取引所 市場第一部 (証券コード 2760)

### ● 「配当金計算書」について

配当金お支払いの際にご送付しております「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用いただくことができます。確定申告をされる株主様は大切に保管ください。

ただし、株式数比例配分方式をご選択いただいている株主様につきましては、源泉徴収税額の計算は証券会社等にて行われます。確定申告を行う際の添付資料につきましては、お取引の証券会社にご確認をお願いいたします。



半導体及び電子デバイス事業にて認証取得

この報告書は、森林認証を受けたFSC®認証紙および、低VOCの植物油インキを使用しています。